



(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
09.07.1997 Patentblatt 1997/28

(51) Int. Cl.⁶: G03F 7/20

(21) Anmeldenummer: 96118016.3

(22) Anmeldetag: 09.11.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE NL

(30) Priorität: 27.12.1995 DE 19548805

(71) Anmelder: Carl Zeiss
D-89518 Heidenheim (Brenz) (DE)

(72) Erfinder:

- Fürter, Gerd
73479 Ellwangen (DE)
- Wangler, Johannes
89551 Königsbronn (DE)
- Dinger, Udo
73447 Oberkochen (DE)
- Ittner, Gerhard
73447 Oberkochen (DE)

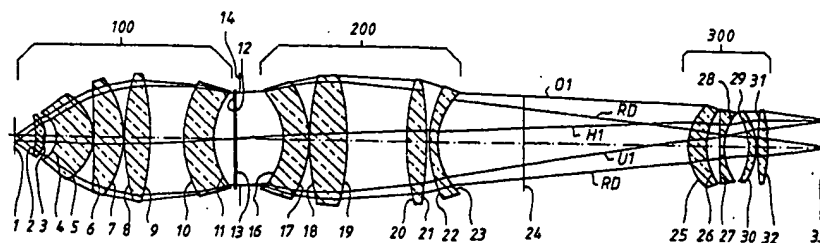
(54) REMA-Objektiv für Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlagen

(57) REMA-Objektiv (123), das eine in endlichem Abstand liegende Objektebene (1) auf die Retikelebene (33) abbildet, mit einer in der retikelnahen Objektivhälfte liegenden Linsengruppe (300), in der die Hauptstrahlhöhen betragsmäßig größer sind als die Randstrahlhöhen, in der eine zerstreue Fläche (28) mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Hauptstrahls in Luft gegen die Flächennormale ($|\sin(i_{\text{Haupt}})|$) größer als 0,35, vorzugsweise größer als 0,5 angeordnet ist.

Es ist auch vorgesehen, daß vor oder vor und hinter dem Schnittpunkt der Hauptstrahlen (H1) mit der optischen Achse mindestens eine optische Fläche (11) eine zu diesem Schnittpunkt hin gekrümmte Fläche ist, mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels gegen die Flächennormale eines Randstrahls in Luft

($|\sin(i_{\text{Rand}})|$) größer als das 0,8-fache der objektseitigen numerischen Apertur (NAO);
daß zwischen Objektebene (1) und Blendenebene (14), welche den Schnittpunkt der Hauptstrahlen (H1) mit der optischen Achse enthält, ein zur Objektebene (1) hin gekrümmter zerstreuer Luftspalt (3, 4) angeordnet ist;
daß es ein Teilobjektiv (100) enthält, welches eine korrigierte Pupillenebene (14) erzeugt;
die Verwendung besonders in einer Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage, in der die Retikel-Maskierung (90) am Ausgang eines Glasstabs (80) angeordnet ist; und
in der das Projektionsobjektiv (400) ein verkleinerndes katadioptrisches Objektiv ist.

FIG. 1



Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein REMA-Objektiv. Dies ist ein Objektiv, mit dem eine Retikel-Maskiereinrichtung (REMA) in die Ebene des Retikels, das die strukturierte Maske für die Lithographie trägt, abgebildet wird. Der auf dem Retikel ausgeleuchtete Bereich wird damit scharf berandet. Gewöhnlich ist die Retikel-Maskiereinrichtung mit verstellbaren Schneiden aufgebaut. Die Abbildung ist normalerweise vergrößernd.

Ein REMA-Objektiv gelangt in Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlagen (Stepper) zum Einsatz.

Aus DE-U 94 09 744 ist eine Beleuchtungseinrichtung für eine mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage bekannt, bei der in angegebener Reihenfolge vorgesehen sind: Lichtquelle, Verschuß, Einkoppelobjektiv (Zoom-Axi-con), Glasstab als Integrator, Retikel-Masking-System, REMA-Objektiv zur Abbildung der im Retikel-Masking-System liegenden Zwischenfeldebene auf das Retikel, enthaltend eine erste Linsengruppe, eine Pupillen-Zwischenebene, eine zweite Linsengruppe, einen Umlenkspiegel, eine dritte Linsengruppe und die Retikel-Ebene mit dem Retikel. Danach folgt ein Projektionsobjektiv, das normalerweise verkleinert und - zum Beispiel bei nicht telezentrischem Eingang - eine innenliegende Pupillenebene enthält, dann der Wafer in der Bildebene.

In dem System nach EP 0 526 242 A1 ist nach dem Integrator, hier ein Wabenkondensor, zunächst ein Projektionsobjektiv vorgesehen, bevor das Retikel-Masking-System folgt. Über zwei Linsengruppen und Spiegel ist das Retikel-Masking-System zur Retikel-Ebene optisch konjugiert, wird also abgebildet. Zugleich wird die Blende am Austritt des Integrators - die sekundäre Lichtquelle - durch die zwei Linsengruppen und Teile des Projektionsobjektivs auf die Pupille des Projektionsobjektivs abgebildet. Zu Bildfehlern wird dabei nichts ausgesagt.

In der PCT/EP95/01719 der Anmelderin ist ein höchstaperturiges katadioptrisches Reduktionsobjektiv für die Mikrolithographie beschrieben, zu dessen Ausführungsbeispiel nach Figur 3 und Tabelle 2 das hier gezeigte Ausführungsbeispiel eines REMA-Objektivs genau passend ist. Die PCT-Anmeldung ist daher, wie auch die DE-U ausdrücklich Teil der Offenbarung dieser Patentanmeldung. Tabelle 2 gibt die Tabelle 2 der PCT-Anmeldung nochmals wieder.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein besonders hochwertiges REMA-Objektiv anzugeben.

Dabei soll die Lage der Hauptstrahlen auf die Eintrittspupille des Projektionsobjektivs abgestimmt sein bzw. für typische Projektionsobjektive passen. Die in der Objektebene des REMA-Objektivs liegenden Blenden-Kanten müssen einwandfrei auf die Retikel-Ebene abgebildet werden und es wird ein freiliegendes korrigiertes Pupillen-Zwischenbild angestrebt, da dann an dessen Ort weitere Blenden und ähnliches, zum Beispiel zur Maskierung von Teilen des Alignmentssystems, angeordnet werden können.

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein REMA-Objektiv nach einem der nebengeordneten Ansprüche 1, 3 oder 6 und die Gesamtanordnung nach Anspruch 11.

Zur Erreichung aller dieser Ziele ist die Einführung großer Winkel in den Strahlengang erfindungsgemäß vorgesehen.

Gemäß Anspruch 1 ist dabei vorgesehen, daß in der retikelseitigen Objektivhälfte eine Linsengruppe liegt, in der die Hauptstrahlhöhen betragsmäßig größer sind als die Randstrahlhöhen, und in der eine zerstreuernde, also konkave Fläche mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Hauptstrahles in Luft ($|\sin(i_{\text{Haupt}})|$) größer als 0,35, insbesondere größer als 0,5 ist.

Damit läßt sich primär die Lage der Hauptstrahlen auf die Eintrittspupille des Projektionsobjektivs abstimmen.

Anspruch 2 baut das vorteilhaft aus, indem in Lichtrichtung hinter dem REMA-Objektiv der reziproke Wert der auf das Retikel bezogenen Hauptstrahlenschnittweite für achsferne Hauptstrahlen im mathematischen Sinne kleiner ist als für achsnahe Hauptstrahlen.

Anspruch 3 sieht vor, daß vor oder aber vor und nach dem Schnittpunkt der Hauptstrahlen mit der optischen Achse - dieser liegt in der Blendenebene - mindestens eine - vorzugsweise eine der nächstgelegenen vier - optischen Flächen eine zu diesem Schnittpunkt hin gekrümmte Fläche ist, mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Randstrahls in Luft ($|\sin(i_{\text{Rand}})|$) größer als das 0,8-fache der objektseitigen numerischen Apertur.

Nach Anspruch 4 ist vorgesehen, daß zwischen Blendenebene und Retikel (Bildebene des REMA-Objektivs) mindestens eine Linsenfläche liegt, an der der größte Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Komastrahls in Luft gegen die Flächennormale $|\sin(i_{\text{Koma max}})|$ größer als 0,8 mal die eingangsseitige numerische Apertur NAO ist.

Nach Anspruch 5 ist dabei zusätzlich vorgesehen, daß die Abbildung von der Objektebene mit dem Retikelmaskierungssystem auf die Retikelebene so gut ist, daß im Bild einer Hell-Dunkel-Kante die Helligkeitswerte 5% und 95% um weniger als 2%, vorzugsweise 0,5%, des Bildfelddurchmessers auseinanderliegen.

Diese Maßnahmen sind also dazu geeignet, Objektkanten, insbesondere die Schneiden der Retikel-Maskierung, sehr exakt abzubilden.

Anspruch 6 sieht vor, daß zwischen Objektebene und Blendenebene, welche den Schnittpunkt der Hauptstrahlen mit der optischen Achse enthält, ein zur Objektebene hin gekrümmter zerstreuer Luftspalt angeordnet ist. Damit wird die gute Korrektur des Zwischenbildes sichergestellt.

Anspruch 7 sieht dazu die Ausbildung eines Teilobjektivs zur Darstellung einer korrigierten Pupillenebene in der Blendenebene des REMA-Objektivs vor.

Mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 8 ergibt sich eine besonders gute Komakorrektur dieses

Teilobjektivs. Dazu ist mindestens eine zur Objektebene hin gekrümmte Hohlfläche vorgesehen, an der der Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Randstrahls in Luft ($|\sin(i_{\text{Rand}})|$) kleiner als 0,8 mal die objektseitige numerische Apertur des REMA-Objektivs ist, und der größte Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Komastrahls ($|\sin(i_{\text{Koma-max}})|$) größer als 0,8 mal die objektseitige numerische Apertur des REMA-Objektivs ist.

5 Die Verwendung eines REMA-Objektivs nach einem oder mehreren der obigen Ansprüche erfolgt vorzugsweise in einer Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage, in der die Retikel-Maske am Ausgang eines Glasstabs angeordnet ist, gemäß Anspruch 9. Hier wird der Objektivteil bis zur Blendenebene benötigt. Bei Systemen mit Wabenkondensor ohne Retikel-Maskierungssystem wird nur der nachfolgende Teil, dessen hinterer Teil eine Feldlinse darstellt, benötigt. Besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ist es, daß am Ende des Glasstabs die Retikel-Maskierung, meist eine verstellbare Blende bestehend aus präzisen Schneiden, angeordnet werden kann, und daß diese sehr
10 präzise auf die Retikel-Ebene abgebildet wird.

Nach Anspruch 10 ist die Verwendung mit einem katadioptrischen Projektionsobjektiv vorgesehen, entsprechend dem beschriebenen Ausführungsbeispiel.

Anspruch 11 beschreibt eine gesamte Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie mit dem REMA-Objektiv, davor einem Glasstab und nachfolgend einem Projektionsobjektiv mit einer Eintrittspupille und gibt dafür die
15 wesentliche Funktion des REMA-Objektivs, zugleich die Retikel-Maskierung präzise in die Retikelebene zu projizieren, und die Austrittspupille des REMA-Objektivs auf die Eintrittspupille des Projektionsobjektivs sauber abzustimmen.

Das führt insgesamt dazu, daß die in einem zwischen Lichtquelle und Glasstab angeordneten Objektiv erzeugte besondere Beleuchtungscharakteristik - gewöhnliche Beleuchtung mit variabler Apertur, also Kohärenzgrad σ , Ringaperturbeleuchtung, symmetrische schiefe Beleuchtung, Quadrupolbeleuchtung - (wie z.B. in EP-A 0 687 956 (94038 P EP) und dortigen Zitaten beschrieben), für alle Punkte des Retikels einwandfrei in die Eintrittspupille des Projektionsobjektivs übertragen wird.

Näher erläutert wird die Erfindung anhand des in der Zeichnung wiedergegebenen Ausführungsbeispiels.

Es zeigen

25 **Figur 1** einen Linsenschnitt eines REMA-Objektivs;

Figur 2 eine schematische Übersicht über eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage.

30 Das im Linsenschnitt Figur 1 gezeigte REMA-Objektiv hat drei Linsengruppen 100, 200, 300. Die Pupillenebene 14 liegt hinter der Planplatte 12/13. Bei der Fläche 23 ist Raum für den Einbau eines Umlenkspiegels, der zur kompakten Unterbringung in der Belichtungsanlage Bedeutung hat. Zwischen der dritten Linsengruppe 300 und der Bildebene 33 bleibt ein freier Arbeitsabstand, so daß für die Befestigung und Handhabung des Retikels genügend Raum bleibt. Eingetragen sind der Hauptstrahl H1, die Randstrahlen RD und der obere O1 und untere U1 Komastrahl. Tabelle 1 gibt
35 die Radien und Abstände der Linsen mit den Flächen 2 bis 32, die alle aus Quarzglas gefertigt sind, bezogen auf die Objektebene 1 und die Bildebene 33 an.

Tabelle 2 gibt die Daten des dazu exakt passenden katadioptrischen Reduktionsobjektivs nach PCT/EP95/01719
Figur 3 und Tabelle 2 an.

In Tabelle 1 ist auch für die Randstrahlen RD, den Hauptstrahl H1 und den oberen O1 und unteren U1 Komastrahl
40 der Sinus des Einfallswinkels auf die Flächen - $\sin(i_{\text{Rand}})$, $\sin(i_{\text{Haupt}})$, $\sin(i_{\text{Koma oben}})$, $\sin(i_{\text{Koma unten}})$ - angegeben.

Figur 2 zeigt einen schematischen Überblick über den optischen Teil einer gesamten Projektionsbelichtungsanlage (Wafer-Stepper).

Ein KrF-Excimer-Laser 50 mit 248 nm Wellenlänge dient als Lichtquelle. Eine Einrichtung 60 dient zur Strahlformung und Kohärenzreduktion. Ein Zoom-Axicon-Objektiv 70 ermöglicht die bedarfsgerechte Einstellung verschiedener
45 Beleuchtungsarten. Es ist, wie die gesamte Anordnung (außer den erfindungsgemäßen Merkmalen des REMA-Objektivs 123) beispielsweise aus der EP-A 0 687 956 oder aus DE-U 94 09 744 (beide von der Anmelderin) bekannt. Das Licht wird in den Glasstab 80 eingekoppelt, der zur Mischung und Homogenisierung dient.

Unmittelbar daran schließt das Retikel-Maskierungssystem 90 an, das in der Objektebene 1 des REMA-Objektivs
50 123 liegt. Dieses besteht aus der ersten Linsengruppe 100, der Pupillenebene (Blendenebene) 14, der zweiten Linsengruppe 200, dem Umlenkspiegel 240, der dritten Linsengruppe 300 und der Bildebene 33. Hier ist das Retikel 330 angeordnet, das von der Wechsel- und Justiereinheit 331 präzise positioniert wird. Es folgt das katadioptrische Projektionsobjektiv 400 nach PCT/EP95/01719 mit der Pupillenebene 410. Die Eintrittspupille liegt im Ausführungsbeispiel der Tabellen 1 und 2 allerdings nahezu im Unendlichen vor dem Projektionsobjektiv. In der Bildebene ist der Wafer 500
55 angeordnet.

Die Hauptstrahlen verlassen die Objektebene 1 des REMA-Objektivs 123 nahezu senkrecht. Zwischen den Linsenflächen 3 und 4 befindet sich der zur Objektebene 1 hin gekrümmte zerstreulichte Luftraum gemäß Anspruch 6.

Nächst der Pupillenebene 14 ist die dünne Planplatte 12/13 angeordnet, als Statthalter für hier mögliche Blenden,

EP 0 783 137 A2

Filter und dergleichen. Die Pupille ist für eine saubere Weiterverarbeitung dieser Blenden etc. ausreichend gut korrigiert. Demgemäß ist der Objektivteil bis zur Pupille 14 als Teilobjektiv korrigiert, dessen Objekt im Unendlichen, dessen Blende am Ort der Objektebene 1 des REMA-Objektivs 123, und dessen Bildebene am Ort der Blendenebene des gesamten REMA-Objektivs 123 liegt, und bei dem die Koma als Querabweichungen kleiner ist als 1 %, vorzugsweise kleiner als 0,2 %, des Bildfelddurchmessers dieser Teilabbildung.

Die Flächen 11 und 16 erfüllen die Bedingung des Anspruches 3, denn sie sind zur Pupillenebene 12 hin gekrümmt und für die Fläche 11 ist $|\sin(i_{\text{Rand}})| = 0,62$, für die Fläche 16 ist $|\sin(i_{\text{Rand}})| = 0,66$. Die objektivseitige numerische Apertur ist $\text{NAO} = 0,60$ (gleich $|\sin(i_{\text{Rand}})|$ an der Objektebene 1). Bei Varianten liegt sie vorzugsweise zwischen 0,35 und 0,75.

Damit ist der Quotient $|\sin(i_{\text{Rand}})| : \text{NAO}$ für beide Flächen größer als 1 und erst recht größer als 0,8. Zwischen einer dieser Flächen mit der Eigenschaft des Anspruchs 3 und der Pupillenebene sollte möglichst nicht mehr als eine Linse liegen.

Zusätzlich ist vorgesehen, daß zwischen Blendenebene 14 und Retikelebene 33 eine Fläche 23 liegt, mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Komastrahles in Luft gegen die Flächennormale $|\sin(i_{\text{Koma max}})|$ größer als 0,8 mal die eingangsseitige numerische Apertur NAO .

Diese Flächen beeinflussen vorteilhaft die Petzvalsumme und die sphärische Aberration.

In der dritten Linsengruppe 300 sind die Hauptstrahlhöhen größer als die Randstrahlhöhen und die Fläche 28 ist zerstreuernd, $|\sin(i_{\text{Haupt}})|$ ist 0,54, also größer als 0,5, wie im Anspruch 1 bevorzugt wird. Entsprechend nahe liegt die dritte Linsengruppe 300 an der Retikelebene 33.

Diese dritte Linsengruppe 300 hat eine positive Brennweite und dient der Anpassung der Hauptstrahlen des REMA-Objektivs 123 an die Hauptstrahlen des Projektionsobjektivs 400. In jedem beleuchteten Punkt der Retikelebene 33 unterscheidet sich der Schwerstrahl des auftreffenden Lichtkegels nur wenig vom vorgegebenen Hauptstrahl des nachfolgenden Projektionsobjektivs 400. Es ist vorgesehen, daß die Winkelabweichung unter 3 Millirad liegt. Bei dem gezeigten Beispiel nach Tabelle 1 in Verbindung mit dem Projektionsobjektiv 400 nach Tabelle 2 liegt diese Abweichung unter 1 Millirad.

Für diese Hauptstrahlanpassung besonders nützlich ist die vorgesehene stark zerstreuernde Fläche 28, für die gilt $|\sin(i_{\text{Haupt}})| = 0,54$. Der Wert entspricht also der Forderung des Anspruchs 1. Dieser große i -Winkel ermöglicht es, den Hauptstrahl H1 der Eintrittspupille 420 des Projektionsobjektivs 400 anzupassen.

Die Verzeichnung des REMA-Objektivs 123 ist auf weniger als 0,5 % korrigiert. Anzustreben sind generell weniger als 3 %, bzw. weniger als 0,5 %. Dazu ist vorteilhafterweise eine krumme Sammelfläche in der dritten Linsengruppe 300 vorzusehen, für die gilt $|\sin(i_{\text{Haupt}})| \geq 0,35$. Dies ist hier die Fläche 25 mit $|\sin(i_{\text{Haupt}})| = 0,47$.

Das REMA-Objektiv gemäß der Erfindung, insbesondere gemäß dem Ausführungsbeispiel, ist auch hinsichtlich der Bereitstellung freier Räume in den Bereichen der Objekt- und Bildebene und der Pupille für die Praxis gut geeignet.

Die gesamte Baulänge 1-33 beträgt 1200 mm, je nach Ausführung können ca. 500 - 2000 mm vorkommen. Der freie Abstand zwischen Objektebene 1 und erster Objektivfläche 2 beträgt rund 30 mm. Mindestens ca. 5 mm werden generell angestrebt, damit in der Objektebene 1 die variable Retikel-Maskierungsblende 90 gut untergebracht werden kann.

Nach der nächst der Pupillenebene 14 angeordneten Planplatte 12/13 ist ein Freiraum von über 60 mm geschaffen, so daß hier gut eine Wechseleinrichtung für Planplatten 12/13 mit unterschiedlicher Filter- und Blendenwirkung angeordnet werden kann.

Zwischen der zweiten 200 und dritten 300 Linsengruppe liegt ein Freiraum, der deutlich länger als der Querschnitt der Lichtröhre ist, so daß im Bereich der eingezeichneten Ebene 24 - aber auch dagegen- verschoben - ein Umlenkspiegel 240 angeordnet werden kann (vgl. Figur 2).

Auch der freie Abstand 32-33 des Objektivs zur Retikelebene ist mit über 90 mm (7,5 % der Baulänge) reichlich bemessen. Über 3 % der Baulänge sind hier bei allen Varianten angestrebt, um für die Halterung des Retikels 330 einschließlich Wechsel- und Justiereinrichtung 331 genügend Platz zu lassen.

Der objektseitige Hauptstrahl ist im Beispiel und vorzugsweise senkrecht zu der Objektebene 1.

Die Objektebene 1 kann mit der Austrittsfläche des Glasstabs 80 zusammenfallen. Zur Anbringung einer variablen Objektfeldblende - der Retikelmaskierung 90 - ist jedoch ein geringer Abstand zum Glasstab 80 nötig, der aber kleiner als 0,8 % der Baulänge des REMA-Objektivs 123 bleibt.

Das REMA-Objektiv 123 bildet die Objektebene 1 im Maßstab $\beta = -4,444$ im Beispiel, generell über 2-fach, in der Regel 3- bis 8-fach vergrößernd ab.

Das ist zum einen dadurch bedingt, daß der Bildfelddurchmesser in der Retikelebene 33 so groß sein muß wie der Objektfelddurchmesser des Projektionsobjektivs 400. Bei einem Bildfelddurchmesser auf dem Wafer 500 von 30 mm muß bei einem 4- bzw. 5-fach reduzierendem Projektionsobjektiv 400 also der Bildfelddurchmesser des REMA-Objektivs 120 mm bzw. 150 mm sein.

Der Durchmesser sinnvoller Glasstäbe 80 ist aber deutlich geringer, so daß hier eine hohe Vergrößerung benötigt wird. Bei Wabenkondensoren sind die Durchmesser aber im allgemeinen deutlich größer als bei Glasstäben, so daß eine solche Vergrößerung dann nicht benötigt wird.

Tabelle 2

5 Wellenlänge $\lambda = 248,38 \text{ nm}$ numerische Apertur $NA = 0,70$
 Abbildungsmaßstab $\beta = -0,25$ Glas: Quarz $n = 1,50834$

	Nr.	Radius	Dicke	Glas
10			46,25	
	1	-208,30	11,38	Quarz
	2	-498,48	1,00	
15	3	368,29	16,30	Quarz
	4	-173,64	55,82	
	5	Plan	66,00	
20	6	-127,78	9,70	Quarz
	7	251,15	79,28	
	8	1891,95	38,73	Quarz
25	9	-160,51	1,03	
	10	-2818,18	15,49	Quarz
	11	263,13	13,96	
30	12	997,93	29,30	Quarz
	13	-273,97	1,00	
35	14	Plan	95,50	Quarz
	15	Plan	95,50	Quarz
	16	Plan	21,10	
40	17	-245,27	15,63	Quarz
	18	3216,71	15,16	
	19	-437,42	Spiegel	
45	20	-3216,71	15,16	
	21	245,27	15,63	Quarz
	22	Plan	21,10	
50	23	Plan	191,0	Quarz
	24	278,04	1,00	

55

EP 0 783 137 A2

Tabelle 1

Wellenlänge Lambda = 248,38 nm numerische Apertur = 0,6
Abbildungsmaßstab β = -4,44

10

Nr.	Radius	Dicke	Glas	RD	01	H1	U1
1	Plan	30.72		.60	.60	.00	-.60
2	-86.28	13.81	Quarz	.38	.47	.11	-.29
3	-44.80	18.11		-.15	.07	.28	.38
4	-39.93	55.00	Quarz	-.43	-.19	.28	.65
5	-76.61	1.00		-.43	-.29	.16	.56
6	-1047.19	43.85	Quarz	.37	.39	.03	-.36
7	-153.10	2.00		-.35	-.25	.11	.45
8	326.10	38.48	Quarz	.45	.46	.01	-.44
9	-396.62	43.07		-.29	-.20	.10	.38
10	164.06	45.00	Quarz	.44	.48	.04	-.40
11	117.72	28.67		.62	.67	.05	-.56
12	Plan	1.50	Quarz	.01	.09	.08	.06
13	Plan	2.00					
14	Blende	67,45					
16	-108.16	37.23	Quarz	-.66	-.62	.03	.69
17	-165.92	1.06		-.38	-.34	.03	.41
18	494.18	55.65	Quarz	.32	.41	.10	-.24
19	-345.37	36.53		-.34	-.33	.02	.36
20	369.96	30.69	Quarz	.13	.22	.10	-.04
21	-685.05	2.57		-.37	-.38	-.00	.36
22	183.76	12.67	Quarz	.14	.23	.11	-.05
23	107.14	127.91		.52	.70	.21	-.34
24	Plan	239.33		-.12	-.04	.05	.17
25	87.96	27.87	Quarz	.17	.69	.47	.27
26	111.57	16.73		.02	.32	.29	.27
27	744.34	8.60	Quarz	-.15	-.14	.03	.19
28	87.96	35.54		.11	.69	.54	.41
29	-105.49	11.35	Quarz	-.22	-.40	-.18	.04
30	-89.35	1.31		-.25	-.59	-.33	-.07
31	403.64	14.72	Quarz	-.06	.17	.22	.28
32	-313.72	94.55		-.18	-.30	-.13	-.05
33	Plan			-.13	-.13	.00	.14

45

50

55

EP 0 783 137 A2

7. REMA-Objektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Teilobjektiv (100) enthält, welches eine korrigierte Pupillenebene (14) erzeugt.
- 5 8. REMA-Objektiv nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß es mindestens eine zur Objektebene (1) hin gekrümmte Hohlfläche (4) aufweist, an der der Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Randstrahls in Luft gegen die Flächennormale ($|\sin(i_{\text{Rand}})|$) kleiner als 0,8 mal die objektseitige numerische Apertur (NAO) des REMA-Objektivs ist, und der größte Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Komastrahls ($|\sin(i_{\text{Koma-max}})|$) größer als 0,8 mal die objektseitige numerische Apertur (NAO) des REMA-Objektivs ist.
- 10 9. REMA-Objektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1-8, gekennzeichnet durch die Verwendung in einer Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage, in der die Retikel-Maskierung (90) am Ausgang eines Glasstabs (80) angeordnet ist.
- 15 10. REMA-Objektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1-9, gekennzeichnet durch die Verwendung in einer Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage, in der das Projektionsobjektiv (400) ein verkleinerndes katadioptrisches Objektiv ist.
- 20 11. Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie mit einer Beleuchtungseinrichtung enthaltend einen Glasstab (80) und ein REMA-Objektiv (123) und mit einem Projektionsobjektiv (400) mit einer Eintritts-Pupillenebene (410), dadurch gekennzeichnet, daß das REMA-Objektiv (123) nach mindestens einem der Ansprüche 1-10 enthaltend Anspruch 7 ausgeführt ist, und daß die Pupillenebene (14) des REMA-Objektivs (123) in die Pupillenebene (410) des Projektionsobjektivs (400) abgebildet wird.

25

30

35

40

45

50

55

EP 0 783 137 A2

	25	4615,58	24,57	Quarz
5	26	262,26	63,39	
	27	-620,91	40,81	Quarz
	28	208,55	1,08	
10	29	-2336,21	24,75	Quarz
	30	-441,28	6,67	
15	31	1144,28	15,29	Quarz
	32	71,95	1,06	
20	33	50,36	36,07	Quarz
	34	60,47	13,64	
	35	3672,41	53,85	Quarz
25	36		6,34	Bild (Wafer)

30

Patentansprüche

- REMA-Objektiv (123), das eine in endlichem Abstand liegende Objektebene (1) auf die Retikelebene (33) abbildet, mit einer in der retikelnahen Objektivhälfte liegenden Linsengruppe (300), in der die Hauptstrahlhöhen betragsmäßig größer sind als die Randstrahlhöhen, in der eine zerstreue Fläche (28) mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Hauptstrahls in Luft gegen die Flächennormale ($|\sin(i_{\text{Haupt}})|$) größer als 0,35, vorzugsweise größer als 0,5 angeordnet ist.
- REMA-Objektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Lichtrichtung hinter dem REMA-Objektiv (123) der reziproke Wert der auf das Retikel (330) bezogenen Hauptstrahlschnittweite für achsferne Hauptstrahlen im mathematischen Sinn kleiner als für achsnahe Hauptstrahlen ist.
- REMA-Objektiv, dadurch gekennzeichnet, daß vor oder vor und hinter dem Schnittpunkt der Hauptstrahlen (H1) mit der optischen Achse mindestens eine optische Fläche (11) eine zu diesem Schnittpunkt hin gekrümmte Fläche ist, mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels gegen die Flächennormale eines Randstrahls in Luft ($|\sin(i_{\text{Rand}})|$) größer als das 0,8-fache der objektseitigen numerischen Apertur (NAO).
- REMA-Objektiv nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Blendenebene (14) und Retikelebene (33) mindestens eine Fläche (23) angeordnet ist mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Komastrahls in Luft gegen die Flächennormale ($|\sin(i_{\text{Koma max}})|$) größer als 0,8 mal die objektseitige numerische Apertur (NAO) des REMA-Objektivs (123).
- REMA-Objektiv nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Abbildung einer Hell-Dunkel-Kante von der Objektebene (1) auf die Retikelebene (33) einen Kantenverlauf ergibt, dessen Helligkeitswerte 5 % und 95 % um weniger als 2 %, vorzugsweise weniger als 0,5 % des Bildfelddurchmessers auseinanderliegen.
- REMA-Objektiv, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Objektebene (1) und Blendenebene (14), welche den Schnittpunkt der Hauptstrahlen (H1) mit der optischen Achse enthält, ein zur Objektebene (1) hin gekrümmter zerstreuer Luftspalt (3, 4) angeordnet ist.

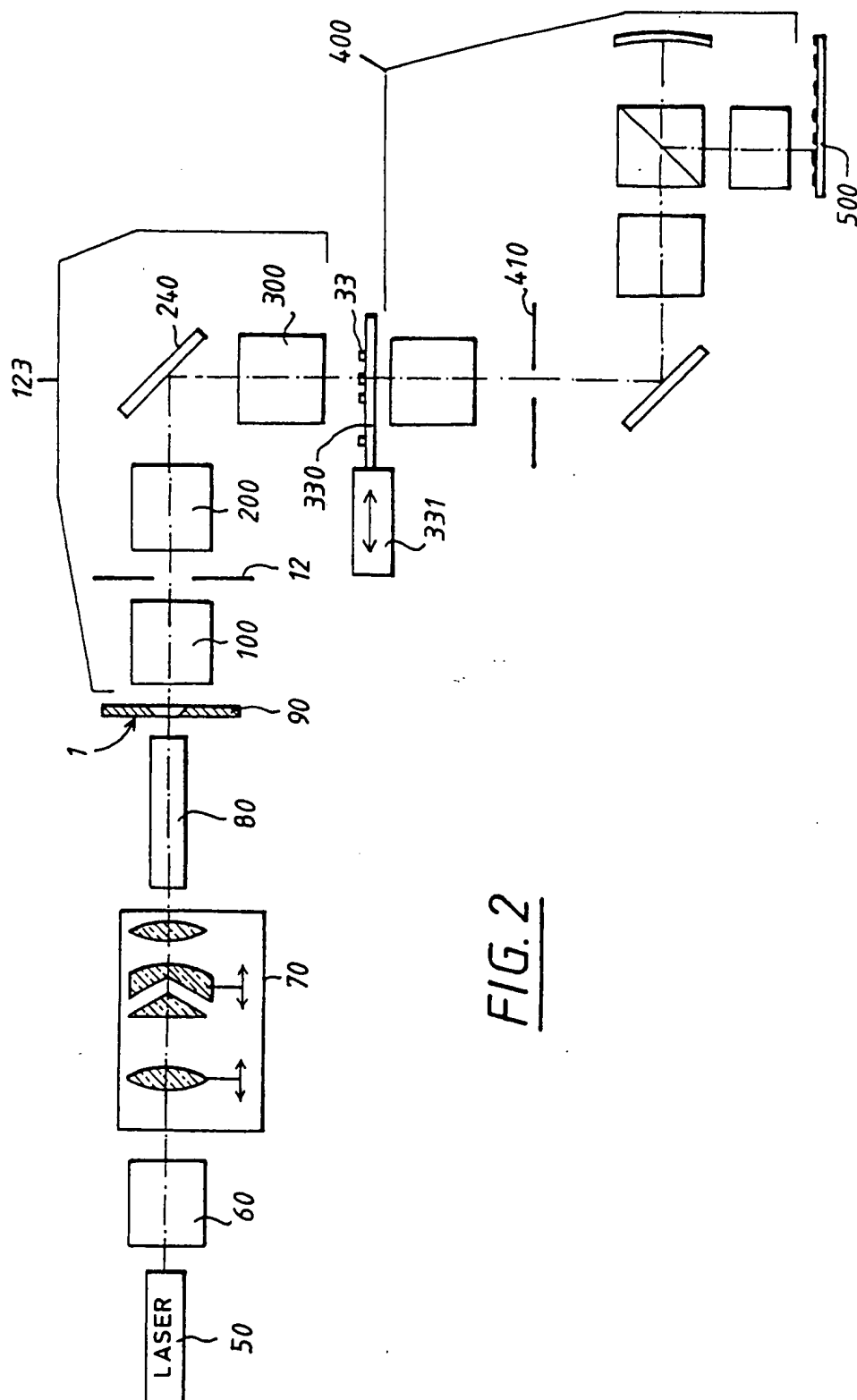
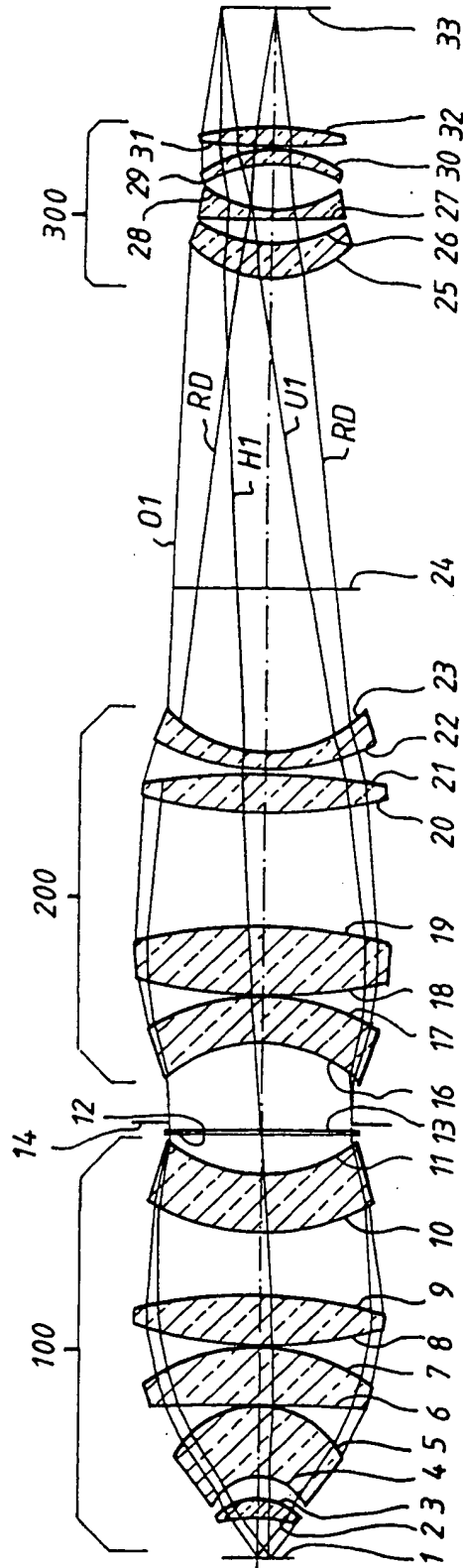
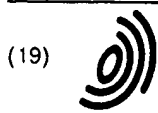


FIG. 2

FIG. 1





(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 783 137 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
27.10.1999 Patentblatt 1999/43

(51) Int. Cl.⁵: G03F 7/20

(43) Veröffentlichungstag A2:
09.07.1997 Patentblatt 1997/28

(21) Anmeldenummer: 96118016.3

(22) Anmeldetag: 09.11.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE NL

(30) Priorität: 27.12.1995 DE 19548805

(71) Anmelder: Carl Zeiss
89518 Heidenheim (Brenz) (DE)

(72) Erfinder:

- Fürter, Gerd
73479 Ellwangen (DE)
- Wangler, Johannes
89551 Königsbrunn (DE)
- Dinger, Udo
73447 Oberkochen (DE)
- Ittner, Gerhard
73447 Oberkochen (DE)

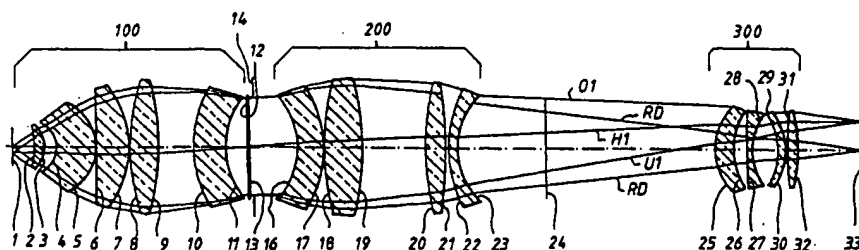
(54) REMA-Objektiv für Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlagen

(57) REMA-Objektiv (123), das eine in endlichem Abstand liegende Objektebene (1) auf die Retikelebene (33) abbildet, mit einer in der retikelnahen Objektivhälfte liegenden Linsengruppe (300), in der die Hauptstrahlhöhen betragsmäßig größer sind als die Randstrahlhöhen, in der eine zerstreuernde Fläche (28) mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels eines Hauptstrahls in Luft gegen die Flächennormale ($|\sin(i_{\text{Haupt}})|$) größer als 0,35, vorzugsweise größer als 0,5 angeordnet ist.

Es ist auch vorgesehen, daß vor oder vor und hinter dem Schnittpunkt der Hauptstrahlen (H1) mit der optischen Achse mindestens eine optische Fläche (11) eine zu diesem Schnittpunkt hin gekrümmte Fläche ist, mit einem größten Betrag des Sinus des Auftreffwinkels gegen die Flächennormale eines Randstrahls in Luft

($|\sin(i_{\text{Rand}})|$) größer als das 0,8-fache der objektseitigen numerischen Apertur (NAO); daß zwischen Objektebene (1) und Blendenebene (14), welche den Schnittpunkt der Hauptstrahlen (H1) mit der optischen Achse enthält, ein zur Objektebene (1) hin gekrümmter zerstreuernder Luftspalt (3, 4) angeordnet ist; daß es ein Teilobjektiv (100) enthält, welches eine korrigierte Pupillenebene (14) erzeugt; die Verwendung besonders in einer Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage, in der die Retikel-Maskierung (90) am Ausgang eines Glasstabs (80) angeordnet ist; und in der das Projektionsobjektiv (400) ein verkleinerndes katadioptrisches Objektiv ist.

FIG. 1



EP 0 783 137 A3

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 96 11 8016

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

30-08-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0687956 A	20-12-1995	DE 4421053 A	21-12-1995
		DE 4441947 A	30-05-1996
		JP 8006175 A	12-01-1996
		US 5675401 A	07-10-1997
EP 0269926 A	08-06-1988	US 4770477 A	13-09-1988
		CA 1304245 A	30-06-1992
		JP 63155014 A	28-06-1988
WO 8401039 A	15-03-1984	US 4474463 A	02-10-1984
		EP 0118444 A	19-09-1984
DE 4417489 A	23-11-1995	WO 9532446 A	30-11-1995
		EP 0710369 A	08-05-1996
		JP 9500986 T	28-01-1997
		US 5742436 A	21-04-1998
EP 0526242 A	03-02-1993	JP 5036586 A	12-02-1993
		DE 69207106 D	08-02-1996
		DE 69207106 T	15-05-1996
		EP 0614097 A	07-09-1994
		KR 9608501 B	26-06-1996
		US 5608575 A	04-03-1997
		US 5631773 A	20-05-1997

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

EP 0 783 137 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 11 8016

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
Y	EP 0 687 956 A (ZEISS CARL ; ZEISS STIFTUNG (DE)) 20. Dezember 1995 (1995-12-20)	1	G03F7/20
A	* Spalte 4, Zeile 12 - Zeile 16 *	3,6	
D	* Abbildung 1 *		
	& DE 94 09 744 U (ZEISS)		
Y	EP 0 269 926 A (PERKIN ELMER CORP) 8. Juni 1988 (1988-06-08)	1	
	* Seite 2, Zeile 51 - Seite 3, Zeile 7 *		
A	E. HECHT : "Optics" 1987, ADDISON-WESLEY XP002113677	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) G03F G02B
	* Kapitel 6.3 11) 'Coma' *		
A	WO 84 01039 A (TRE SEMICONDUCTOR EQUIPMENT CO) 15. März 1984 (1984-03-15)	1,3,6	
	* Seite 6 - Seite 7 *		
	* Abbildung 2 *		
A,D	DE 44 17 489 A (ZEISS CARL FA) 23. November 1995 (1995-11-23)	1	
	* Seite 2, Zeile 52 - Seite 3, Zeile 56 *		
	*, Satz 1A *		
A,D	EP 0 526 242 A (CANON KK) 3. Februar 1993 (1993-02-03)		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 30. August 1999	
		Prüfer Luck, W	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 150 03/82 (P/C/G)